

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成30年4月12日(2018.4.12)

【公開番号】特開2018-32854(P2018-32854A)

【公開日】平成30年3月1日(2018.3.1)

【年通号数】公開・登録公報2018-008

【出願番号】特願2017-154893(P2017-154893)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

C 2 3 C 16/455 (2006.01)

C 2 3 C 16/458 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 G

H 0 1 L 21/31 B

C 2 3 C 16/455

C 2 3 C 16/458

【手続補正書】

【提出日】平成30年2月27日(2018.2.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 7】

温度コントローラ 1 4 2 が、加熱プレート 1 1 2 上に配置された複数の加熱素子（熱制御素子（T C E : t h e r m a l c o n t r o l e l e m e n t）1 4 4 など）に接続されてよい。例えば、加熱素子 1 4 4 は、マルチゾーン加熱プレートにおけるそれぞれの区画に対応するマクロ加熱素子、および / または、マルチゾーン加熱プレートの複数の区画にわたって配置されたマイクロ加熱素子のアレイを含みうるが、これらに限定されない。温度コントローラ 1 4 2 は、複数の加熱素子 1 4 4 を制御して基板支持体 1 0 6 および基板 1 0 8 の温度を制御するために用いられる。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 0】

基板支持体 1 0 6 は、エッジリング 1 8 0 を備える。本開示の原理に従ったエッジリング 1 8 0 は、基板 1 0 8 に対して移動可能（例えば、垂直方向に上下に移動可能）である。例えば、エッジリング 1 8 0 は、後に詳述するように、コントローラ 1 6 0 に応答して、アクチュエータを介して制御されてよい。エッジリング 1 8 0 は、ガス注入パラメータに従って基板処理中に調節されてよい。一部の例において、エッジリング 1 8 0 は、さらなるサイド調整ガスを注入するためのガス注入ノズルを備えてもよい。

【手続補正 3】

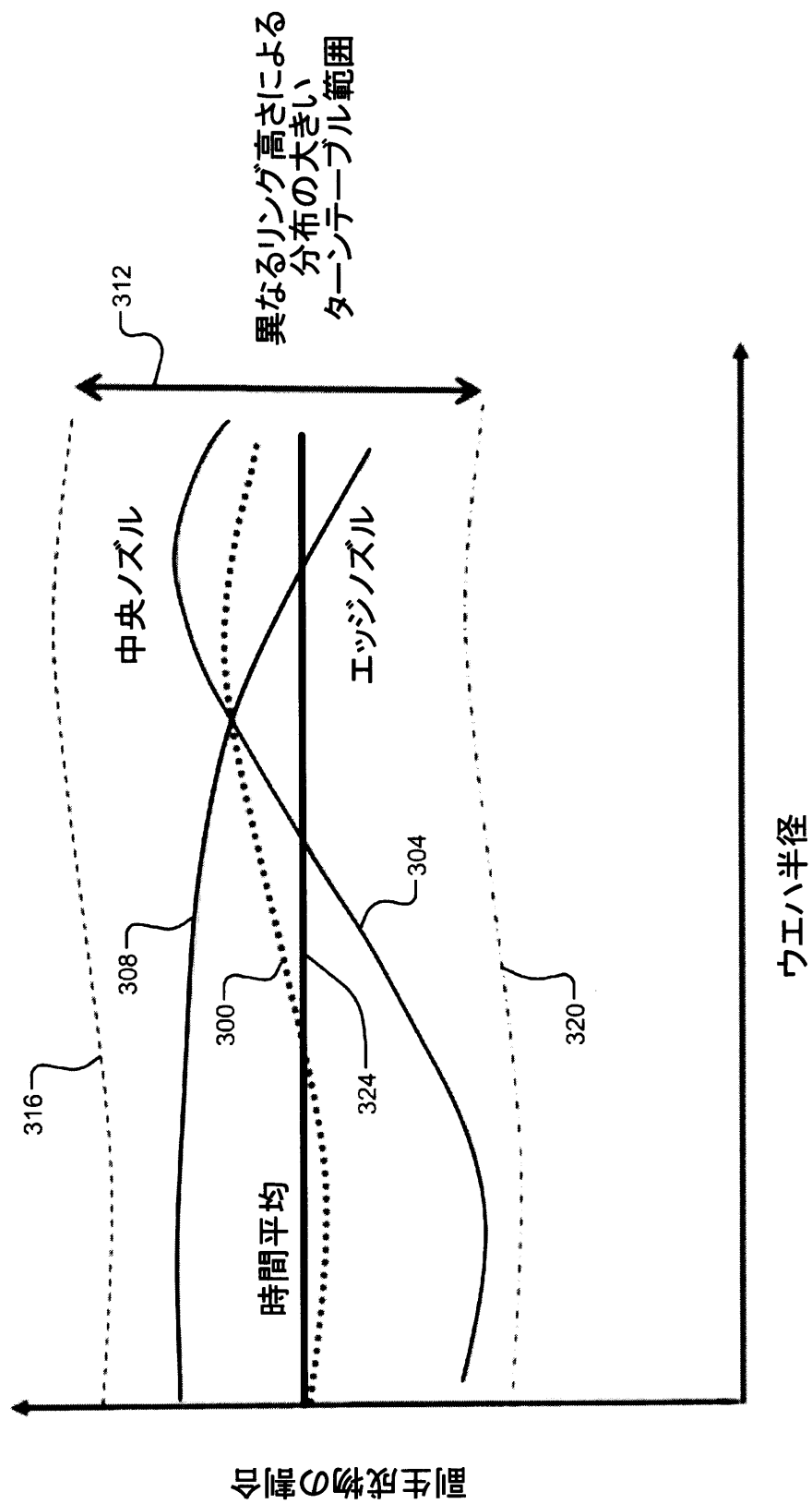
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 3】

**FIG. 3**